

6-534998-5 ✓ 有效

AMPMODU | Modu Connector System

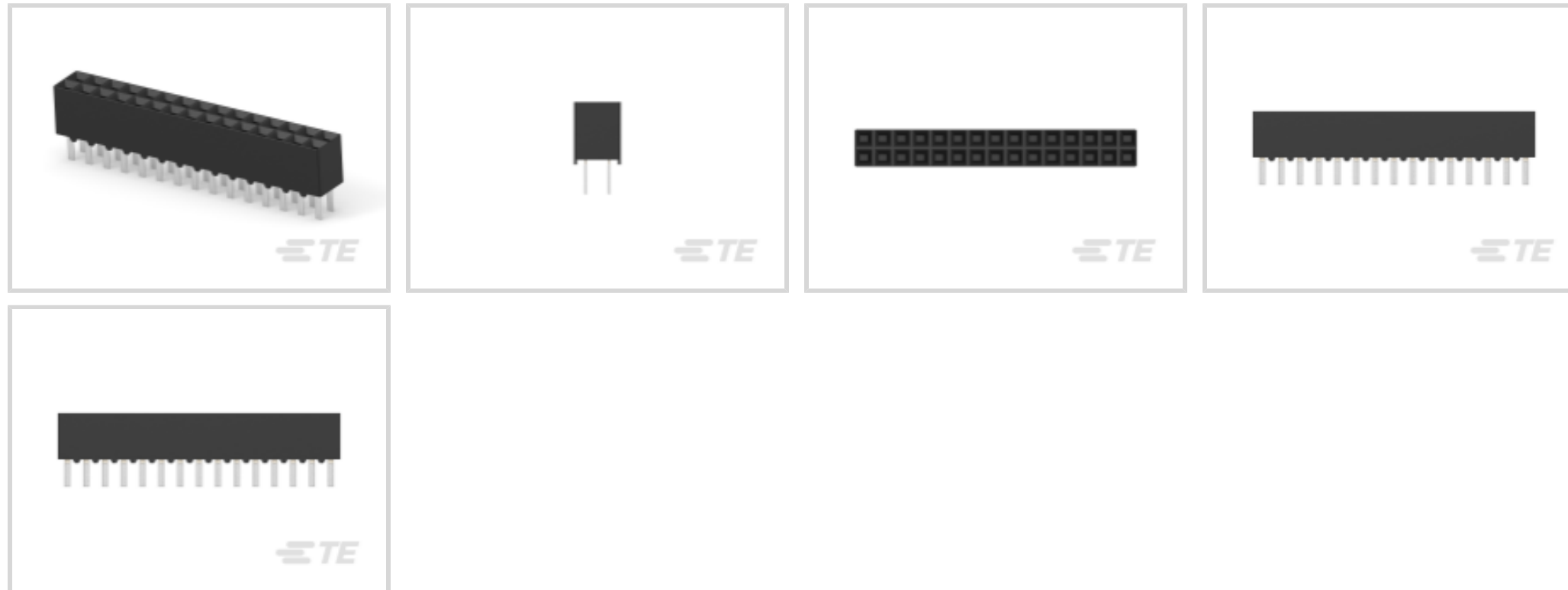
TE 内部编号 6-534998-5

PCB Mount Receptacle, Vertical, Board-to-Board, 30 Position, 2.54 mm [.1 in] Centerline, Gold, Through Hole - Solder, Signal, Modu Connector System

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



连接器系统: 板对板

位数: 30

行数: 2

中心线 (间距) : 2.54 mm [.1 in]

PCB 安装方向: 垂直

## 产品特性

### 产品类型特性

施加的压力	标准
连接器系统	板对板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装母端

### 结构特性

板对板配置	平行
可堆叠	是
位数	30
行数	2
PCB 安装方向	垂直

### 电气特征

介质耐压 (最大值)	750 VAC
绝缘电阻	5000 MΩ



工作电压	333 VAC
------	---------

### 主体特性

连接器外形	低
主要产品颜色	黑色

### 接触件特性

端子保护类型	闭合入口壳体
端子接触部长度	3.77 mm[.148 in]
接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3.81 – 7.61 μm
端子接合区域电镀材料厚度	.762 μm[30 μin]
端子形状和构造	圆形, 圆形
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	磷青铜
端子接触部电镀材料	金
端子类型	插座
端子额定电流 (最大值)	2 A

### 端接特性

矩形端接柱体和尾部厚度	.2 mm[.008 in]
矩形端接柱体和尾部宽度	.7 mm[.028 in]
端接柱体和尾部长度	3.18 mm[.125 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

### 机械附件

连接器安装类型	板安装
接合对准	不带
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	不带

### 壳体特性

接合入口位置	顶部
外壳材料	热塑性
中心线 (间距)	2.54 mm[.1 in]

### 尺寸

堆叠高度	9.02 mm[.355 in]
------	------------------



连接器高度	5.03 mm[.198 in]
-------	------------------

PCB 厚度 (建议)	1.57 mm[.055 – .094 in]
-------------	-------------------------

行间距	2.54 mm[.1 in]
-----	----------------

### 使用环境

壳体温度额定值	标准
---------	----

工作温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]
--------	----------------------------

### 操作/应用

焊接工艺特性	板支座
--------	-----

电路应用	Signal
------	--------

### 行业标准

与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476
-------------	-----------------------

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

### 包装特性

封装数量	15
------	----

封装方法	Box, Tube
------	-----------

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
--	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
------	------------------------------

焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C
--------	---------------

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。

免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



## 该系列中的其他产品 | Modu Connector System



## 客户还购买了





## 文档

### 产品图纸

[30 MODIV VRT DR CE 100/125](#)

英文版本

### CAD 文件

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_6-534998-5\\_R.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

#### 3D PDF

3D

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_6-534998-5\\_R.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_6-534998-5\\_R.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

### 数据表/目录页

[AMPMODU\\_INTERCONNECTION\\_SYSTEM\\_SECTION5](#)

英文版本

### 产品规格

#### 应用规格

英文版本